

## Publikationen

- : Dynamic high pressure treatment (dHP) as a new approach towards inactivation of microorganisms and pathogens. Posterpräsentation. In: 6th International Conference on High Pressure Bioscience and Biotechnology (HPBB) 2010, Freising.
- : Dynamic High Pressure Treatment - Improving the Inactivation of Microorganisms and Pathogens. In: 6th International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR) 2011, Nantes, Frankreich.
- : Dynamic High Pressure Treatment - Von der dynamischen Hochdruckinaktivierung zum quasi-kontinuierlichen Sterilisationsprozess. In: ProcessNet-Jahrestreffen der Fachgruppe Hochdruckverfahrenstechnik (HDVT), Hamburg.
- : Quasi-continuous High Pressure Preservation - A novel reactor concept paves the way for large-scale processing. In: 9th European Congress on Chemical Engineering (ECCE), Den Haag, Niederlande.
- : Hochdruckinaktivierung von Mikroorganismen: Mit Dynamik zum quasi-kontinuierlichen Prozess. With Dynamic High Pressure Treatment Towards a QuasiContinuous Inactivation of Microorganisms. In: Chemie Ingenieur Technik, vol. 86, no. 5, pp. 675-678. DOI: 10.1002/cite.201300146.
- : Hochdruckinaktivierung: Unterschiedliches Druckprofil - gleicher Zellschaden?. In: Chemie Ingenieur Technik, vol. 87, no. 8. DOI: 10.1002/cite.201550038.
- : Quasi-kontinuierliche Hochdruckbehandlung - Ein innovativer Prozess vereint hygienisches Design und Energieeffizienz. In: Chemie Ingenieur Technik, vol. 88, no. 9. DOI: 10.1002/cite.201650252.
- : Quasi-kontinuierliche Hochdruckbehandlung - Ein innovatives Prozesskonzept schafft den Spagat zwischen Hygienischem Design und Energieeffizienz. In: ProcessNet-Jahrestagung 2016, Aachen.
- : Euglena gracilis as a promising eukaryotic model system for fast detection of high pressure induced cell destruction. In: Environmental and Experimental Botany, vol. 133, pp. 50-57. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2016.09.008.
- : Static and Dynamic, but not Pulsed HighPressure Treatment Efficiently Inactivates Yeast. In: Chemical Engineering & Technology, vol. 40, no. 1, pp. 130-137. DOI: 10.1002/ceat.201600290.